

【原因・判断ポイント・発生工程】回路線幅と殆ど同じ幅の不透明化したDFR剥離片が、隣接導体間に跨って再付着した為に出来たもの（現像～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】与线宽几乎同样宽度的不透明DFR碎片横跨相邻的导线，再次附着所引起的（显影～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
An opaque dry film debris having almost the same width as a conductor is peeled off and re-adhered to bridge neighbouring conductors (Development - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-8-4-14 ビアホールズレ短絡／导通孔偏移的短路 / Short by misaligned via hole

【特徴】ビアホール下ランドとビアホールの中心にズレがあり、下ランドからはみ出したブラインドビア底部が下側層まで伸びている状態の短絡

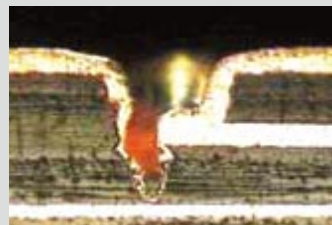
【特征】导通盲孔偏离连接盘中心，盲孔底部超出连接盘，延伸到下层的短路。

【Characteristics】 There is a misalignment between via-hole center and via-bottom-land center. The conductor protruded from a blind via-bottom-land extends to a lower conductive layer becoming a short.

【原因・判断ポイント・発生工程】ビアホール用レーザ穴加工の中心が、ビア下ランドの中心からずれたことにより、レーザ穴がビア下ランド層をつきぬけ次の層まで達したため、スルーホール銅めっきがそこまで析出し出来たもの（露光、積層、レーザ穴あけ、スルーホールめっき工程）

【原因、判断要点、发生工序】激光盲孔偏离底部连接盘，致使盲孔偏离连接盘延伸到下层，镀铜时在该部位沉积而引起的（曝光、层压、激光钻孔、镀通孔工序）。

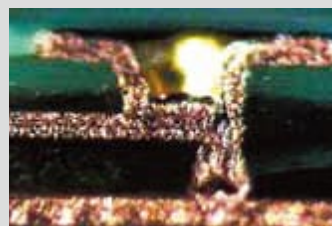
【Causes/processes involved/keys to judgment】
The center of a laser drilled via hole is misaligned from the center of the via-bottom-land. The laser drilled hole pierces the layer of the via-bottom-land and reaches the next layer. Copper deposits on this hole resulting in a short. (Exposure, lamination, laser-drilling and through hole plating processes)



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×